

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

04.01.2005

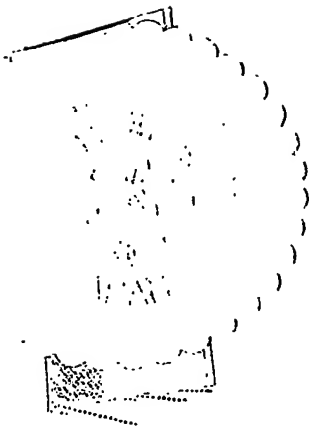
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2004年 2月27日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2004-054816  
[ST. 10/C]: [J. P 2004-054816]

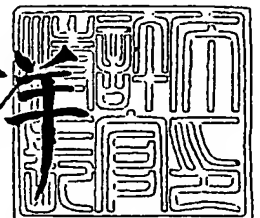
出 願 人  
Applicant(s): 住友金属鉱山株式会社



2005年 2月17日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 SU-P290  
【提出日】 平成16年 2月27日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01B 5/14  
【発明者】  
    【住所又は居所】 千葉県市川市中国分 3-18-5 住友金属鉱山株式会社 市川  
    研究所内  
    【氏名】 中山 徳行  
【発明者】  
    【住所又は居所】 千葉県市川市中国分 3-18-5 住友金属鉱山株式会社 市川  
    研究所内  
    【氏名】 阿部 能之  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000183303  
    【氏名又は名称】 住友金属鉱山株式会社  
    【代表者】 福島 孝一  
【代理人】  
    【識別番号】 100065824  
    【氏名又は名称】 篠原 泰司  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100104983  
    【氏名又は名称】 藤中 雅之  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 017938  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1  
    【包括委任状番号】 9709824

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、かつ波長633nmにおける屈折率が1.65以上1.85以下であることを特徴とする透明導電膜。

## 【請求項 2】

波長633nmにおける屈折率が1.7以上1.8以下であることを特徴とする請求項1記載の透明導電膜。

## 【請求項 3】

比抵抗値が $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{+8} \Omega \cdot \text{cm}$ であることを特徴とする請求項1または2に記載の透明導電膜。

## 【請求項 4】

算術平均高さ(Ra)が2.0nm以下、好ましくは1.0nm以下であることを特徴とする請求項1～3のいずれか一つに記載の透明導電膜。

## 【請求項 5】

ガラス板、石英板、樹脂板および樹脂フィルムから選ばれた透明基板の片面もしくは両面に、請求項1～4のいずれか一つに記載の透明導電膜を形成してなることを特徴とする透明導電性基材。

## 【請求項 6】

樹脂板および樹脂フィルムから選ばれた透明基板の片面もしくは両面上に、少なくとも一層以上のガスバリア膜、ならびに請求項1～4のいずれか一つに記載の透明導電膜を順に形成してなることを特徴とする透明導電性基材。

## 【請求項 7】

ガスバリア膜として、窒化シリコン、酸化窒化シリコンまたは酸化シリコンから選ばれた、いずれか1種類以上の膜が含まれることを特徴とする請求項6記載の透明導電性基材。

## 【請求項 8】

Ga、InおよびOからなり、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、主に $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 型構造のGaInO<sub>3</sub>相とピックスバイト型構造のIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相から構成され、かつ次式で定義されるX線回折ピーク強度比が45%以下であり、密度が $5.8 \text{ g/cm}^3$ 以上であることを特徴とする薄膜製造用焼結体ターゲット。

$$\text{In}_2\text{O}_3 \text{ 相 } (400) / \beta\text{-GaInO}_3 \text{ 相 } (111) \times 100 \quad [\%]$$

## 【請求項 9】

比抵抗値が $9.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることを特徴とする請求項8に記載の薄膜製造用焼結体ターゲット。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】透明導電膜、透明導電性基材ならびに薄膜製造用焼結体ターゲット

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、表示ディスプレイの透明電極や帯電防止機能、もしくは液晶光学素子に用いられる透明導電膜、透明導電性基材ならびにスパッタリング法やイオンプレーティング法で用いる薄膜製造用焼結体ターゲットに関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

透明でかつ電気抵抗の小さい透明導電膜、ならびにそれを透明基板に形成した透明導電性基材は、その透明性と導電性を必要とする用途、例えば、液晶ディスプレイ、ELディスプレイといったフラットパネルディスプレイや、タッチパネルの透明電極など、表示デバイスの用途、帯電防止フィルムの用途、さらには液晶光学素子の用途など、多種多様の電気分野、電子分野の用途に広く使用されている。一般に透明導電膜としては、酸化インジウムにスズを添加した膜、すなわちITO (Indium-Tin-Oxide) の結晶膜が広く用いられている。ITO結晶膜は比抵抗が低く、可視光域の光透過率が良好な、優れた材料である。これまでは、ほとんどの用途において、ITOの特性を制御することによって対応してきた。

## 【0003】

しかし、最近、有機もしくは無機ELや電子ペーパーなど、新しい表示デバイスの開発が進むとともに、透明導電膜への要求も多様化し、通常のITO結晶膜では、もはや対応できなくなってきた。

例えば、タッチパネルの場合、表面抵抗は $500 \sim 1000 \Omega/\square$ の高めのほうがよく、むしろ視認性を重要視する傾向にある。視認性を落とさないためには、屈折率の低い透明導電膜が必要となる。ITOの屈折率は $2.0 \sim 2.2$ 程度と高く、視認性が良くないため、少なくとも屈折率 $1.8$ 前後の透明導電膜が必要とされている。

## 【0004】

また結晶膜ではなく、非晶質膜であることも重要になってきている。一般に、酸化物の結晶膜は結晶粒界が弱く、強度的に弱いという問題がある。特許文献1で課題とされているように、結晶膜は、特に摺動に弱く、膜にクラックや剥離が発生してしまうため、ペン入力を行うタッチパネルには不向きである。

他の例として、フレキシビリティを特徴とする電子ペーパー用途においては、曲げに対して割れにくい透明導電膜が必須となる。一般に、酸化物の結晶膜は結晶粒界が弱く割れやすいのに対し、結晶粒界が存在しない非晶質膜は割れにくいことが知られていることから、曲げに対して強い透明導電膜として、非晶質の透明導電膜の適用が提案されている。またこの用途では、PETフィルムなど、熱に弱い基板を用いるため、室温近傍で非晶質の透明導電膜を成膜することが求められる。この非晶質の透明導電膜は、タッチパネルの場合と同様に、低屈折率であることが重要なのは言うまでもない。

## 【0005】

また、有機EL用途でも、非晶質であって、かつ屈折率の低い透明導電膜が好ましい。上記ITOのような結晶膜では、結晶成長による突起状の組織が存在するため、局所的な電流集中が起こり、均一な表示が難しくなるという問題がある。すなわち、膜表面が極めて平坦な非晶質膜が求められている。また、発光層からの光の取り出し効率を上げるため、ITOなどより、低い屈折率の透明導電膜が求められている。特に、今後開発が進むことが予想されるフレキシブル有機ELについては、電子ペーパーと同様の理由から、室温近傍で成膜して得られる非晶質の透明導電膜が求められている。

## 【0006】

特許文献2には、陽極と陰極との間に有機発光層を含む有機層が挟持されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、陰極が、有機層に接する側から電子注入電極層、透明導電膜、抵抗率 $1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の金属薄膜の順で積層されてなるとともに、

陰極の外側に透明薄膜層が形成されている有機エレクトロルミネッセンス素子が提案されており、インジウム (In)、亜鉛 (Zn)、酸素 (O) からなる酸化物を用いた非晶質透明導電膜が用いられている。

#### 【0007】

特許文献3には、可視光透過率が高く、低抵抗な特性を有する透明導電膜として、In、SnおよびZnを含む複合金属酸化物膜が、少なくとも1種の $\text{In}_4\text{Sn}_3\text{O}_{12}$ 結晶、もしくはIn、SnおよびZnから構成される微結晶あるいは非晶質を形成し、含まれる金属成分組成として、 $\text{Sn} \times 100 / (\text{In} + \text{Sn})$ で示されるSn量が40～60原子%であり、 $\text{Zn} \times 100 / (\text{In} + \text{Zn})$ で示されるZn量が10～90原子%含有する透明導電膜が記載されている。

#### 【0008】

また、特許文献4には、従来の透明導電膜とはほぼ同様のバンドギャップ3.4 eVと光屈折率2.0を有し、 $\text{MgIn}_2\text{O}_4$ や $\text{In}_2\text{O}_3$ より一段と高い導電性、すなわち、より低い抵抗率と、優れた光学的特性を有する透明導電膜として、マグネシウム (Mg)、インジウム (In) を含む酸化物、 $\text{MgO}-\text{In}_2\text{O}_3$ で示される擬2元系において、 $\text{In} / (\text{Mg} + \text{In})$ で示されるIn量が70～95原子%含有する透明導電膜が提案されている。

しかしながら、このような従来から提案されている多くの非晶質の透明導電膜は、いずれも屈折率2.0以上であるため、視認性を求める用途に適しているとはいえない。

#### 【0009】

また、特許文献5には、四価原子のような異価ドーパントを少量ドーブしたガリウム・インジウム酸化物 ( $\text{GaInO}_3$ ) が提案されている。該酸化物の結晶膜は、透明性に優れ、約1.6の低い屈折率を示すため、ガラス基板との屈折率整合が改善される上、現在用いられている広禁制帯半導体と同程度の電気伝導率を実現できることが記載されている。しかし、前述したように、最近の表示デバイスに求められる非晶質膜ではなく結晶膜であること、加えて、結晶膜を得るためには、工業的に不利な、基板温度250～500℃での高温成膜が必要であることから、そのまま利用することが難しいのが現状である。

#### 【0010】

他に、特許文献6には、従来知られている $\text{GaInO}_3$ とはかなり異なる組成範囲で、 $\text{GaInO}_3$ や $\text{In}_2\text{O}_3$ より一段と高い導電性、すなわち、より低い抵抗率と、優れた光学的特性を有する透明導電膜として、 $\text{Ga}_2\text{O}_3-\text{In}_2\text{O}_3$ で示される擬2元系において、 $\text{Ga} / (\text{Ga} + \text{In})$ で示されるGa量が15～49原子%含有する透明導電膜が提案されている。特に、該透明導電膜の光屈折率は組成を変えることにより約1.8から2.1まで変えることができるという特長を有すると記載されている。しかし、実施例には、屈折率に関しては何ら記載されていない。さらに詳しい内容については、特許文献6の発明者らによって、別に非特許文献1に報告されており、文献のFig. 6には、特に室温で成膜したGa、InおよびOからなる透明導電膜の屈折率が示されている。それによれば、 $\text{In}_2\text{O}_3$ 膜の屈折率は約2.1、 $\text{Ga} / (\text{Ga} + \text{In})$ で示されるGa量が5～80原子%含有する透明導電膜の屈折率は1.9～2.3、 $\text{Ga}_2\text{O}_3$ 膜の屈折率は約1.8であり、特に $\text{Ga} / (\text{Ga} + \text{In})$ で示されるGa量が50原子%含有する透明導電膜は約2.0であると記載されている。

上記からもわかるように、室温近傍での成膜が可能であって、非晶質であり、かつ屈折率の低い透明導電膜は未だに得られていないのが実状である。

#### 【0011】

したがって、上記のタッチパネル、電子ペーパーおよび有機EL用途における、低屈折率の透明導電膜の要請や、摺動や曲げに対して割れにくい非晶質の透明導電膜の要請、膜面が極めて平坦な非晶質の透明導電膜の要請、さらには室温近傍で成膜可能であることの必要性等に対して、いまだバランスよく十分に答えているものは無く、これらの要求に応える、新たな透明導電膜が求められている。

【特許文献1】特開2002-313141号公報

【特許文献2】特開平10-294182号公報

【特許文献3】特開平10-83719号公報

【特許文献4】特開平8-264023号公報

【特許文献5】特開平7-182924号公報

【特許文献6】特開平9-259640号公報

【非特許文献1】T. Minami et al: J. Vac. Sci. Technol. A14 (3), May/Jun 1996 P1689-1693

【非特許文献2】R. D. Shannon et al: J. inorg. nuclear Chem., 1968, Vol. 30, pp. 1389-1398

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

本発明は、以上のような最近の表示デバイスの技術的背景から、非晶質であって、かつ可視光域での屈折率が低く、摺動や曲げによる剥離、割れなどが起こりにくく、膜面が極めて平坦であり、さらには室温近傍で成膜可能な透明導電膜を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本願発明者等は、前記課題を解決するため、透明基板上に多くの酸化物膜を形成し、該酸化物膜の光学特性や非晶質膜の作製の容易さ等について調査を行った。その結果、Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、かつGaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、波長633nmにおける屈折率が1.65以上1.85以下、比抵抗値が $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{+8} \Omega \cdot \text{cm}$ である透明導電膜が得られることを見出し、本願発明に至った。

【0014】

すなわち、第1の発明は、Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、かつ波長633nmにおける屈折率が1.65以上1.85以下であることを特徴とする透明導電膜である。

【0015】

第2の発明は、波長633nmにおける屈折率が1.7以上1.8以下であることを特徴とする第1の発明による透明導電膜である。

【0016】

第3の発明は、比抵抗値が $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{+8} \Omega \cdot \text{cm}$ であることを特徴とする第1の発明または第2の発明による透明導電膜である。

【0017】

第4の発明は、算術平均高さ(Ra)が2.0nm以下、好ましくは1.0nm以下であることを特徴とする第1～3のいずれか一つの発明による透明導電膜である。

【0018】

第5の発明は、ガラス板、石英板、樹脂板および樹脂フィルムから選ばれた透明基板の片面もしくは両面に、第1～4のいずれか一つの発明による透明導電膜を形成してなることを特徴とする透明導電性基材である。

【0019】

第6の発明は、樹脂板および樹脂フィルムから選ばれた透明基板の片面もしくは両面上に、少なくとも一層以上のガスバリア膜、ならびに第1～4のいずれか一つの発明による透明導電膜を順に形成してなることを特徴とする透明導電性基材である。

【0020】

第7の発明は、ガスバリア膜として、窒化シリコン、酸化窒化シリコンまたは酸化シリ

コンから選ばれた、いずれか1種類以上の膜が含まれることを特徴とする第6の発明による透明導電性基材である。

【0021】

第8の発明は、Ga、InおよびOからなり、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、主に $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>型構造のGaInO<sub>3</sub>相とピクスパイト型構造のIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相（以下、特に断らない限り、 $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相と略す）から構成され、かつ次式で定義されるX線回折ピーク強度比が45%以下であり、さらに密度が5.8 g/cm<sup>3</sup>以上であることを特徴とする薄膜製造用焼結体ターゲットである。

$$\text{In}_2\text{O}_3\text{相}(400) / \beta\text{-GaInO}_3\text{相}(111) \times 100 \quad [\%]$$

【0022】

第9の発明は、比抵抗値が $9.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることを特徴とする第8の発明による薄膜製造用焼結体ターゲットである。

【発明の効果】

【0023】

本発明の透明導電膜は、Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、かつGaを全金属原子に対して49.1%以上65原子%以下含有し、比抵抗値が $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{+8} \Omega \cdot \text{cm}$ であり、かつ波長633 nmにおける屈折率1.65以上1.85以下である透明導電膜である。すなわち、該透明導電膜は、従来得られていなかった、可視光域において低屈折率を有し、さらには非晶質膜特有の割れにくさや、算術平均高さの低さといった優れた特徴を併せ持っている。また、室温近傍で成膜可能であり、工業的にも利用価値が高い。また、本発明の薄膜製造用焼結体ターゲットは、上記特徴の透明導電膜を得るために、 $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相(111)反射に対するIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相(400)反射のピーク強度比を45%以下に抑え、かつ密度が5.8 g/cm<sup>3</sup>以上であり、さらには比抵抗値が $9.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下としており、上記特徴の本発明の透明導電膜を得るために、必須である。したがって、これらの透明導電膜、それを形成した透明導電性基材、ならびに使用する薄膜製造用焼結体ターゲットは、今後も多岐に広がる表示デバイスの各用途に有用である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

次に、本発明の実施の形態を示すが、本発明は下記例に限定されるものではない。

本発明の透明導電膜は、Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、かつ波長633 nmにおける屈折率が1.65以上1.85以下であることを特徴とする透明導電膜である。

【0025】

本発明の透明導電膜は、Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有することが好ましい。Ga量49.1原子%未満では、屈折率は高くなり、従来の透明導電膜と同等になってしまう。また、Ga量が65原子%を超えた場合においても屈折率は高くなってしまふ。

また、比抵抗値は、成膜時に非晶質膜中に導入する酸素量に依存するが、 $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{+8} \Omega \cdot \text{cm}$ の範囲で比抵抗値の制御が可能である。さらに多量の酸素を導入すれば、絶縁膜とすることも可能である。

【0026】

また、本発明の透明導電膜は、算術平均高さ(Ra)が2.0 nm以下であることが好ましい。ここで、算術平均高さ(Ra)は、JIS B0601-2001の定義に基づいている。算術平均高さ(Ra)が2.0 nmを超えていると、有機ELなど、膜面の平坦性が要求される用途において好ましくない。

【0027】

本発明の透明導電膜を成膜する方法としては、スパッタリング法、イオンプレーティング法、溶液塗布法、CVD法などが挙げられる。生産性などの理由を考慮すれば、直流プ

ラズマを用いたマグネトロンスパッタリング法（DCマグネトロンスパッタリング法）が好ましい。

#### 【0028】

基板には、ガラス板、石英板、樹脂板および樹脂フィルムから選ばれた透明基板を用いることが好ましいが、表示デバイス用基板であればこの限りではない。

#### 【0029】

スパッタリング法を用いて本発明の透明導電膜を作製する場合、本発明の低い屈折率の非晶質透明導電膜を得るためには、本発明のターゲットを用いることが重要である。

本発明のターゲットは、Ga、InおよびOからなり、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、主として $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相とIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相から構成され、かつ次式で定義されるX線回折ピーク強度比が45%以下であり、さらに密度が5.8 g/cm<sup>3</sup>以上であることを特徴とする薄膜製造用焼結体ターゲットである。

$$\text{In}_2\text{O}_3\text{相}(400)/\beta\text{-GaInO}_3\text{相}(111) \times 100 \quad [\%]$$

ここで、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相は酸素欠損が導入されたものでもよく、Inの一部にGaが置換されたものでもよい。またGa/In原子数比が化学量論組成から多少ずれたものでもよく、 $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相は酸素欠損が導入されたものでもよい。

#### 【0030】

上記のように、本発明の薄膜製造用焼結体ターゲットは、Ga、InおよびOからなる焼結体であって、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有することが好ましい。この組成範囲外になると、形成された非晶質膜がターゲットと同じ組成になった場合、上記と同じ理由から、低い屈折率を実現することができない。ただし、成膜条件によってターゲット組成と非晶質組成がほぼ同等とならない場合、この限りではない。

#### 【0031】

また、本発明のターゲットは、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相の占める割合が少ないほうが好ましい。すなわち、上式で定義される、X線回折における $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相の(111)反射とIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相の(400)反射のピーク強度比（回折ピークの面積強度比）が45%以下であることが好ましい。このピーク強度比が45%を超える場合、上記組成範囲内であっても、2.0～2.2の高い屈折率を示すIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相による影響が大きくなり、1.65以上1.85以下の低い屈折率を実現することができない。

#### 【0032】

なお、JCPDSカード（ASTMカード）によれば、X線回折における $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相ならびにIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相の主ピークは、それぞれ(111)反射および(222)反射によるが、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相(222)反射は $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相(002)反射と重なるため、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相に関しては、次に強度の高い(400)反射で評価している。

#### 【0033】

非特許文献2には、特に、Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=1:1の $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相を作製する場合に、未反応のIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相が残りやすいことが記載されている。In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相は、2.0～2.2の高い屈折率を示すため、薄膜製造用焼結体ターゲットに含まれた場合、それを用いて成膜した膜の屈折率も高くなってしまう。

#### 【0034】

本発明では、薄膜製造用焼結体ターゲット中に、この未反応のIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相が生成することを抑制するべく、原料粉末、混合条件、および焼結条件の検討を行った。

すなわち、常圧焼結法を用いる場合、原料粉末は、純度3N以上が好ましく、また解砕によって平均粒径は3μm以下に調整されていることが好ましい。配合粉末、有機バインダおよび分散剤などは均一な状態が得られるまで混合することが好ましい。成形には、均一な応力をかけることが可能な、静水圧プレスなどを用いることが好ましい。焼結温度は1250°C以上1400°C以下、焼結時間は12時間以上とすることが好ましく、酸素気流中で焼結すればなお好ましい。なお、上記の条件は、常圧焼結の場合に好ましい条件であり、ホットプレス法などの加圧焼結法を用いる場合はその限りではない。



## 【0035】

また、本発明の薄膜製造用焼結ターゲットの作製工程において、原料粉末の解砕後の平均粒径や焼結条件などによっては、 $\text{GaInO}_3$ 相とは異なる $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 相や不可避生成相の $\text{Ga}_2\text{O}_3$ 相が生成する場合がある。本発明の焼結ターゲットは、主に $\beta\text{-GaInO}_3$ 相と $\text{In}_2\text{O}_3$ 相からなるが、上記の $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 相が、次式で定義されるX線回折強度比で70%以下であれば含まれていても良い。

$$(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3\text{相による反射}(2\theta=28^\circ\text{近傍}) / \{\text{In}_2\text{O}_3\text{相}(400) + \beta\text{-GaInO}_3\text{相}(111)\} \times 100 \quad [\%]$$

ここで $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 相による反射 $(2\theta=28^\circ\text{近傍})$ と記述しているが、JCPDSカード(ASTMカード)によれば、 $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 相の結晶構造と面指数は特定されておらず、面間隔とX線回折相対強度比のみが特定されているためである。

上式で70%を超える $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 相を含む薄膜製造用焼結体ターゲットを用いた場合でも、形成された非晶質透明導電膜の屈折率は1.65以上1.85以下の範囲の低い屈折率を示す。しかし、 $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 単相の焼結体は $5\sim 10\Omega\cdot\text{cm}$ 程度の高い比抵抗を示すため、薄膜製造用焼結体ターゲット中に上式で70%を超える量の $(\text{Ga}, \text{In})_2\text{O}_3$ 相が含まれると成膜速度が低下し、生産性が悪くなる。したがって、上式で70%以下であることが好ましい。なお、 $\text{Ga}_2\text{O}_3$ 等未反応物などの不可避不純物については、X線回折でピークが観測されない程度であれば含まれていても良い。

## 【0036】

また、本発明の薄膜製造用焼結体ターゲットは、焼結体の密度が $5.8\text{g}/\text{cm}^3$ 以上であることが好ましい。 $5.8\text{g}/\text{cm}^3$ 未満である場合、スパッタリングにおける異常放電の発生頻度が高まり、結果として良質の低屈折率の非晶質透明導電膜を得ることができない。

他に、本発明の薄膜製造用焼結体ターゲットは、比抵抗値が $9.0\times 10^{-1}\Omega\cdot\text{cm}$ 以下であることが好ましい。比抵抗値がそれを超える場合、DCマグネトロンスパッタリングが可能であっても、成膜速度が低下するため、生産性が低くなる。

これらの条件を満足しない薄膜製造用焼結体ターゲットで成膜を行った場合、特許文献6および非特許文献1に記載されているように、導電性をほとんど示さない $\text{Ga}_2\text{O}_3$ 膜を除き、1.85を超える高い屈折率の非晶質膜のみしか得ることができず、しかも生産性も低くなる。

## 【0037】

本発明の透明導電性基材は、透明基板の片面もしくは両面上に、本発明の透明導電膜を形成してなる。表示デバイスがガスバリア性を必要とする場合は、透明導電性基材にガスバリア機能を付与するため、透明基板と透明導電膜の間に、少なくとも一層以上のガスバリア膜を形成することが好ましい。ガスバリア膜には、窒化シリコン、酸化窒化シリコンまたは酸化シリコンのうち、いずれか1種類以上を含むことが好ましい。また、ガスバリア膜には、無機膜に限らず、有機膜を含んでもよい。

## 【0038】

他に、本発明の透明導電膜は、波長633nmにおいて1.65以上1.85以下の低い屈折率を示すという特長を有することから、この特長を活かせる用途であれば、透明電極以外への応用も可能である。例えば、電気抵抗が高くてもよい帯電防止膜や、絶縁膜でもよい単なる光学薄膜としての応用が可能である。

## 【実施例】

## 【0039】

(実施例1～3)

純度4Nの $\text{Ga}_2\text{O}_3$ 粉末および $\text{In}_2\text{O}_3$ 粉末を、それぞれ平均粒径 $3\mu\text{m}$ 以下にボールミル解砕して調整した。その後、 $\text{Ga}/(\text{Ga}+\text{In})$ で表されるGaが50原子%となるよう配合し、有機バインダ、分散剤ならびに可塑剤とともにボールミルによって48時間混合し、スラリーを作製した。続いて、得られたスラリーを、スプレードライヤーによって噴霧乾燥し、造粒粉末を作製した。

## 【0040】

次に、得られた造粒粉末をゴム型に入れ、静水圧プレス機によって191mm $\phi$ 厚さ約6mmの成形体を作製した。同様にして得られた成形体を酸素気流中、それぞれ1250 $^{\circ}$ C、1350 $^{\circ}$ C、1400 $^{\circ}$ Cで、20時間、常圧焼結した。各焼結体に円周加工ならびに表面研削加工を施し、直径約6inch、厚さ約5mmの形状にした。

## 【0041】

ICP発光分光分析法（セイコーインスツルメンツ製SPS4000使用）で求めた焼結体のGa量、純水を用いてアルキメデス法（東洋精機製作所製高精度自動比重計使用）で測定した密度、四端子法（三菱化学製LORESTA-IP、MCP-T250使用）で測定した比抵抗、ならびにX線回折（理学電機工業製、CuK $\alpha$ 線使用）によって得られたIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相（400）/ $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相（111）ピーク強度比、を図1に示した表にまとめた。また、図2には焼結温度1350 $^{\circ}$ Cで得た焼結体のCuK $\alpha$ 線によるX線回折パターンを示した。

## 【0042】

次に、これらの焼結体を冷却銅板にボンディングし、薄膜製造用焼結体ターゲットとして用いた。スパッタリング装置は、アネルバ製特SPF-530Hを使用した。基板にはコーニング社7059基板と屈折率測定用のSi基板（コマツ電子金属製）を用い、ターゲット面と平行になるように配置した。基板-ターゲット間距離は60mmとした。スパッタリングガスはArとO<sub>2</sub>からなる混合ガスとし、酸素の比率を1.5%、全ガス圧を0.5Paに設定した。投入電力は200Wとした。以上の条件でDCマグネトロンスパッタリングによる室温成膜を行った。放電は安定し、アーク放電の発生など、異常は確認されなかった。成膜時間を調整し、膜厚200nmの透明導電膜を得た。

## 【0043】

図3に1350 $^{\circ}$ Cで焼結したターゲットを用いて成膜した薄膜のX線回折図を示す。明確なピークはなく、非晶質膜であることが確認された。他のターゲットで成膜した膜でも同様に非晶質であった。図1に、各ターゲットで成膜した膜のICP発光分光分析法で求めた組成、屈折率（エリブソメータ：溝尻光学工業所製DHA-XA使用）、比抵抗、ならびに算術平均高さ（Ra）（原子間顕微鏡：Digital Instrument製Nanoscope III使用）の測定結果を示した。

## 【0044】

（実施例4～6）

Ga/(Ga+In)で表されるGa量を49.5、55、65原子%に変更して、実施例2と同様の条件にてターゲットを作製し、成膜を行った。

実施例1～3と同様、異常な放電は確認されなかった。図1に、実施例1～3と同様、ターゲットならびに薄膜について調べた結果を示した。また、得られた薄膜の構造をX線回折によって調べたところ、実施例1～3と同様、全て非晶質膜であった。

## 【0045】

（実施例7）

基板温度を200 $^{\circ}$ Cに変更して、実施例2と同様の成膜を行った。基板温度を200 $^{\circ}$ Cに上げたにもかかわらず、実施例1～6と同様、得られた膜は非晶質膜であることが、X線回折によって確認された。図1に、この膜の諸特性を示した。

## 【0046】

（実施例8、9）

スパッタガス中の酸素の比率を3.0%および5.0%に変更して、実施例6と同様の成膜を行った。実施例1～7と同様、得られた膜は非晶質膜であることが、X線回折によって確認された。図1に、この膜の諸特性を示した。

## 【0047】

（実施例10）

片面ハードコート付きの厚さ125 $\mu$ mのPETフィルムに、実施例2と同様の条件で厚さ50nmの膜を室温で成膜し、ペン摺動耐久性試験で評価した。ポリアセタール製の

ペン（先端の形状：0.8mmR）に5.0Nの荷重をかけ、10万回（往復5万回）の直線摺動試験を、上記透明導電膜付きPETフィルム基板に行った。この時の摺動距離は30mm、摺動速度は60mm/秒とした。この摺動耐久性試験後に、目視および実態顕微鏡によって観察したが、摺動部の白化や膜の剥離、割れは認められなかった。

#### 【0048】

（比較例1～3）

$Ga/(Ga+In)$  で表されるGaを40.0、49.0および66原子%に変更した以外は実施例2と同条件として、薄膜製造用焼結体ターゲットを作製した。図1に、焼結体の密度、比抵抗、ならびにX線回折によって得られた $In_2O_3$ 相(400)/ $\beta-GaInO_3$ 相(111)ピーク強度比を示した。

次に、これらの焼結体ターゲットを用いて、実施例1～3と同様の方法で成膜した。成膜時に、異常な放電は発生しなかった。得られた膜の構造をX線回折で調べたところ、いずれも非晶質であった。図1に、これらの非晶質膜についての、ICP発光分光分析法によって求めた膜組成、屈折率、比抵抗、ならびに算術平均高さ(Ra)の測定結果を示した。

#### 【0049】

（比較例4、5）

実施例1～3と同様の焼結体ターゲットを、焼結温度1100°ならびに1200°Cに変更して作製した。図1に、焼結体の相対密度および比抵抗を示した。なお、X線回折によって構造解析を行ったところ、焼結温度1100°Cの場合、 $\beta-GaInO_3$ 相はほとんど生成せず、 $(Ga, In)_2O_3$ 相と $In_2O_3$ 相のみが生成していた。したがって、 $In_2O_3$ 相(400)/ $\beta-GaInO_3$ 相(111)ピーク強度比を求めることができなかった。なお、 $In_2O_3$ 相(400)のピーク強度は実施例1～3より高く、多量の $In_2O_3$ 相が生成していることが明らかであった。また、焼結温度1200°Cでは、 $\beta-GaInO_3$ 相、 $(Ga, In)_2O_3$ 相、ならびに $In_2O_3$ 相の3相が生成していた。図1に、1200°Cの $In_2O_3$ 相(400)/ $\beta-GaInO_3$ 相(111)ピーク強度比のみを示した。

焼結温度1100°Cのターゲットを用いて成膜したところ、成膜中にアーク放電が頻発した。焼結温度1200°Cのターゲットを用いた場合でも、1100°Cほどではないが、アーク放電は多発した。すなわち、1100°Cならびに1200°Cで焼結した、密度が5.8g/cm<sup>3</sup>未満のターゲットを用いた場合、スパッタ成膜中にアーキングが多発してしまい、膜の破損や成膜速度の変動が大きい等の問題が生じるなど、安定した成膜ができない問題が生じた。得られた膜はX線回折による構造解析の結果、いずれも非晶質膜であった。図1に、得られた膜の、ICP分析法による膜組成、屈折率、比抵抗、ならびに算術平均高さ(Ra)の測定結果を示した。

#### 【0050】

（比較例6）

スパッタガス中の酸素の比率を6.0%に変更して、実施例8、9と同様の成膜を行った。実施例8、9と同様、得られた膜は非晶質膜であることが、X線回折によって確認された。図1に、この膜の諸特性を示した。

#### 【0051】

（比較例7）

実施例10と同様の基板に、ITO(10wt%SnO<sub>2</sub>)ターゲットを用いて、酸素比率2.0%に変更した点を除けば、実施例1～3と同様の要領で室温にて成膜した。AFM(原子間力顕微鏡:Digital Instruments製Nanoscope III使用)によって膜の表面観察を行ったところ、非晶質中に10nm前後の突起状の結晶相が認められた。このITO膜付きフィルム基板で、実施例8と同様の直線摺動試験を行った。試験後に、目視および実体顕微鏡によって観察したところ、摺動部の白化ならびに膜の剥離、割れが認められた。

#### 【0052】

## 「評価」

図1の実施例1～9の結果から、Ga、InおよびOからなり、かつ $Ga/(Ga+In)$ で表されるGaを49.1原子%以上65原子%以下含有する本発明の透明導電膜の特徴がわかる。すなわち、該膜は、波長633nmにおける屈折率が1.65以上1.85以下と低く、比抵抗値が $9.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot cm$ 以下であって、算術平均高さ(Ra)が2.0nm以下の膜面が極めて平坦な、表示デバイスとして必要にして十分な特性を有する。

## 【0053】

同様に、実施例1～9の結果から、Ga、InおよびOからなり、かつ $Ga/(Ga+In)$ で表されるGaを49.1原子%以上65原子%以下含有する本発明の薄膜製造用焼結体ターゲットの特徴がわかる。すなわち、次式で定義されるX線回折ピーク強度比が45%以下であり、さらに密度が $5.8 g/cm^3$ 以上、比抵抗値が $9.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot cm$ 以下であって、上記透明導電膜を得るために必要にして十分な特性を有する。

$In_2O_3$ 相(400)/ $\beta-GaInO_3$ 相(111)  $\times 100$  [%]

## 【0054】

特に、実施例2～6、8および9から、密度が $6.2 g/cm^3$ 以上の薄膜製造用ターゲットを用いて、室温成膜を行った場合、波長633nmにおける屈折率は、1.7以上1.8以下の範囲にあることがわかる。

## 【0055】

比較例1～3から、 $Ga/(Ga+In)$ で表されるGaが49.1原子%以上65原子%以下とする本発明の透明導電膜の組成範囲をはずれた場合、本来の特徴が発揮されないことがわかる。すなわち、Gaが49.1原子%未満、もしくは65原子%を超えた場合には、屈折率は1.85を超えてしまう。

## 【0056】

また、比較例4、5から、上記定義の薄膜製造用焼結体ターゲットのX線ピーク強度比が45%を超えた場合、そのターゲットを用いて成膜した膜は、上記組成範囲内であっても、屈折率は1.85を超えてしまう。

## 【0057】

比較例6から、過剰な酸素を導入して成膜した場合、比抵抗値が $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{+8} \Omega \cdot cm$ の範囲を超えた高い抵抗となってしまう。しかし、導電性を必要とせず、光学用途でのみ用いる場合、この膜は有用である。

## 【0058】

実施例10と比較例7の比較から、本発明の透明導電膜が、従来のITO膜と比較して、外部からの力学的作用に対して劣化しにくい膜であることが実証された。すなわち、本発明の透明導電膜は、タッチパネルや電子ペーパーなどの表示デバイスに必要にして十分な特性を有することが明らかとなった。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0059】

【図1】焼結体のICP発光分光分析法で求めた焼結体のGa量、純水を用いてアルキメデス法で算出した密度、四端子法で測定した比抵抗、ならびにX線回折(CuK $\alpha$ 線使用)によって得られた $In_2O_3$ 相(400)/ $\beta-GaInO_3$ 相(111)ピーク強度比、をまとめた表である。

【図2】焼結温度1350°Cの焼結体のCuK $\alpha$ 線によるX線回折パターンを示した図である。

【図3】1350°Cで焼結したターゲットを用いて成膜した薄膜のX線回折図である。

【書類名】 図面

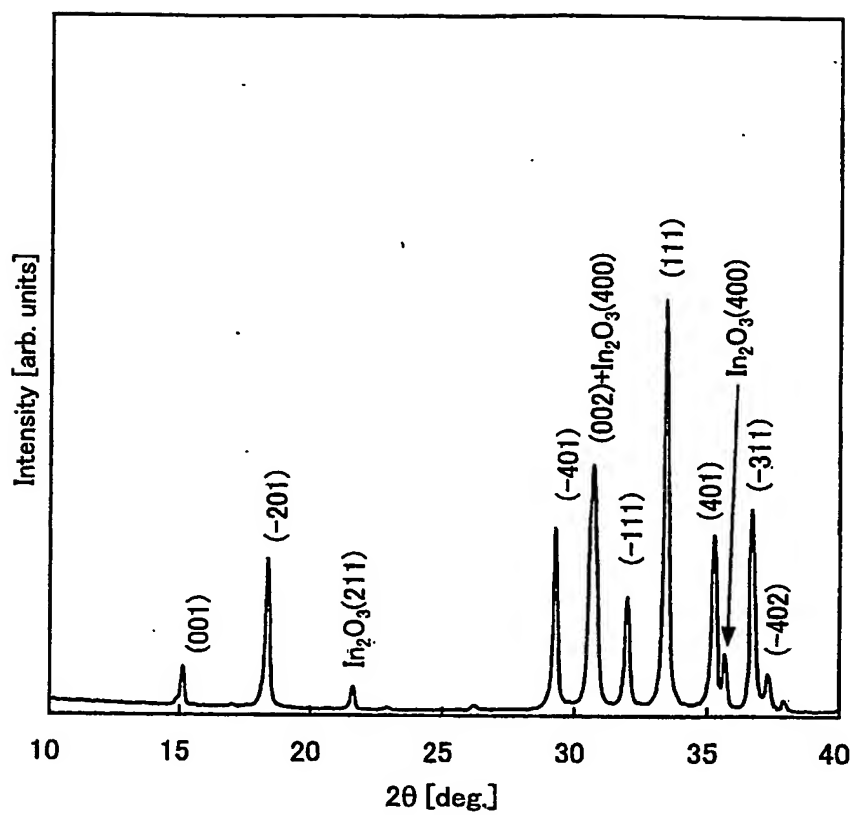
【図1】

	ターゲット評価				薄膜評価				
	焼結温度 [°C]	Ga量 [at%]	真密度 [g/cc]	(400)/(111)強度比 [%]	基板温度 [°C]	Ga量 [at%]	屈折率	比抵抗 [Ωcm]	算術平均高さ(Ra) [nm]
実施例1	1250	50.1	5.83	45	25	50.2	1.85	$3.4 \times 10^{-2}$	0.52
実施例2	1350	50.1	6.38	15	25	50.6	1.70	$2.6 \times 10^{-2}$	0.39
実施例3	1400	50.2	6.38	17	25	50.4	1.72	$2.3 \times 10^{-2}$	0.37
実施例4	1350	49.4	6.31	33	25	49.1	1.76	$1.8 \times 10^{-2}$	0.66
実施例5	1350	54.8	6.31	8	25	55.2	1.77	$8.2 \times 10^{-2}$	0.82
実施例6	1350	65.0	6.21	0	25	65.0	1.80	$6.2 \times 10^{-1}$	1.38
実施例7	1350	50.1	6.38	15	200	50.5	1.65	$1.0 \times 10^{-2}$	0.45
実施例8	1350	65.0	6.21	0	25	64.9	1.80	$4.2 \times 10^{-5}$	1.41
実施例9	1350	65.0	6.21	0	25	65.0	1.78	$9.8 \times 10^{-7}$	1.36
比較例1	1350	40.2	6.38	78	25	39.9	1.92	$4.5 \times 10^{-3}$	1.12
比較例2	1350	48.9	6.31	62	25	49.0	1.89	$8.8 \times 10^{-3}$	0.61
比較例3	1350	66.1	6.24	0	25	66.0	1.88	$9.2 \times 10^{-1}$	2.12
比較例4	1100	50.1	5.22	*	25	49.8	1.94	$9.3 \times 10^{-2}$	1.45
比較例5	1200	50.0	5.56	85	25	50.1	1.88	$7.4 \times 10^{-2}$	0.40
比較例6	1350	65.0	6.21	0	25	64.9	1.76	$7.5 \times 10^{-8}$	1.38

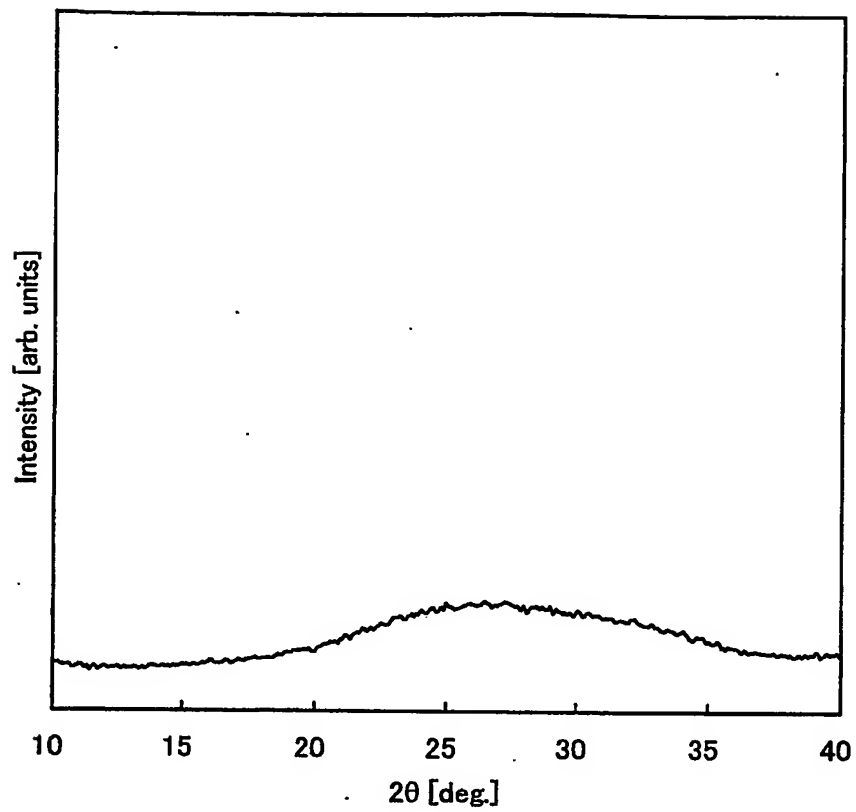
\*β-GaInO3相が生成しなかったため、(400)/(111)強度比が得られなかった。

\*β-GaInO<sub>3</sub>相が生成しなかったため、(400)/(111)強度比が得られなかった。

【図 2】



【図 3】





## 【書類名】要約書

## 【要約】

【課題】非晶質であって、かつ可視光域での屈折率が低く、摺動や曲げによる剥離、割れなどが起こりにくく、膜面が極めて平坦であり、さらには室温近傍で成膜可能な透明導電膜を提供する。

【解決手段】本発明の透明導電膜は、Ga、InおよびOからなる非晶質酸化物膜であって、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、かつ波長633nmにおける屈折率が1.65以上1.85以下である。スパッタリング法を用いて本発明の透明導電膜を作製する場合、薄膜製造用焼結体ターゲットとして、Ga、InおよびOからなり、Gaを全金属原子に対して49.1原子%以上65原子%以下含有し、主として $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相とIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相から構成され、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相(400)/ $\beta$ -GaInO<sub>3</sub>相(111) X線回折ピーク強度比が45%以下であり、さらに密度が5.8g/cm<sup>3</sup>以上であることが重要である。

【選択図】なし

特願 2 0 0 4 - 0 5 4 8 1 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 1 8 3 3 0 3 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区新橋 5 丁目 1 1 番 3 号

氏 名

住友金属鉱山株式会社

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019595

International filing date: 28 December 2004 (28.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-054816  
Filing date: 27 February 2004 (27.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse